

**株式会社東京精密 2022年度(2023年3月期) 決算説明会**  
**質疑応答 要約**

2023年5月12日 開催

- 本資料は、上記日時に開催された2022年度(2023年3月期) 決算説明会(Web開催)の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
- 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- なお、本資料では、半導体製造装置(または同セグメント)を「SPE」、精密計測機器(同左)を「計測」と表記します。

**1. 2022年度の為替実績を確認したい。**

- 1ドル135.5円。

**2. 2023年度のSPE受注環境について、ボトム時期の想定とその蓋然性を聞きたい。**

- SPEの受注はこの4-6月期がボトムと考える。足許では、まだら模様ではあるが、DDIC関連顧客や中国OSATで稼働率の回復がみられる。
- また、資料にあるように、半導体の製造プロセスが大きく変わる局面にある。1つは、ハイエンドのロジック・メモリデバイスの高精度温度制御であり、当社にはその対策があること、もう1つは、Wafer on Wafer, Die on Wafer に代表されるHybrid Bondingであり、この夏以降 開発需要が活発になり、下期以降の受注増加が想定されるためである。

**3. 2022年度1-3月期の計測受注高に関する見解と、今後の見通しの見解を伺いたい。**

- 2022年度は、自動車関連需要が緩慢ななか、半導体製造装置分野メーカー様への事業機会が増加していた。しかし、1-3月期に入り、顧客が慎重な姿勢に転じ、これが1-3月期受注の想定対比下振れの要因となった。
- 現在、世の中のモノづくり全般に停滞気味ではあるが、取り組んでいるEV、半導体、航空機、医療、オートメーションなど、いわゆる成長分野の事業機会が増加しており、多くの商談を得ている。更に、内需は全般に安定しており、受注は安定して増加してゆくものとする。

4. **SPE の 3 月末受注残高は、引き続き高水準である。これらの出荷納期の割合、生産スロットの調整や納期延伸の見通しなどを伺いたい。**
  - 受注残の出荷納期は、2023 年度上期・下期・2024 年度上期以降で、概ね 5:3:2 の割合であり、納期が 1-2 年超となるものも存在する。
  - 実現性の低い案件は精査を行っており、1-3 月期は 20 億円程度 取消処理を実行した。今後も精査を続けてゆく。
  - 納期延伸要請は引き続き存在するが、前倒し要請、新規引合もあるので、スロット調整で対応する所存。今後、事業環境が想定以上に好転した場合は、2024 年上期納期の案件も 2023 年度下期へ前倒しされる可能性が考えられる。
  
5. **現時点での中国の SPE 引合の動向を聞きたい。**
  - パワー半導体関連の引き合いは非常に強いものがある。EV 化の流れを受けた設備投資需要が活発であり、継続性があるものと想定する。
  
6. **SPE 受注・売上に占めるパワーならびに SiC 向けの比率を伺いたい。**
  - 1-3 月期の受注高におけるパワー半導体向けは約 25%、SiC は 10%程度と推定。また同期間の売上高では、それぞれ 20%弱、10%弱と推定。
  
7. **SiC 関連需要の見通し、シェアなどの情報を伺いたい。**
  - SiC 関連製品では、1 年先の生産スロットが埋まっている。また、現在の需要は基板加工(研削)が主体であるが、プロセス後の加工(研削量がさらに増加する)で、装置・消耗品ともに需要が増加すると期待している。
  - シェアは正確に把握していないが、SiC ウェーハの研削プロセスでは、一定のシェアを獲得していると推定。
  
8. **現在の部材調達状況について伺いたい。**
  - 改善はされたものの、長納期の部材があり、特に電源・セラミック部材関連でその傾向が顕著。
  
9. **飯能工場(埼玉県)の稼働計画、今後の見通しを伺いたい。**
  - 7 月の竣工式に先立ち、プローバ生産ラインの移転を 6 月中に開始する。
  - 人員については、3 年程前から人員を早期採用・育成していたことや、工場と併せ、寮の建設なども進めていたので、大きなボトルネックではない。
  - さらに、八王子工場での生産拡大のため、外部倉庫で保管していた部材も飯能工場へ移動させることにより、一定の経費節減が見込める。
  - 八王子ではグラインダ増産に向け、クリーンルームの増設等を検討する。

10. 2023 年度の設備投資計画は、予想 EBITDA(注：営業利益+減価償却費)対比で、会社が設定する MAX50%に相当する。2024 年度以降はどのような見込みか。

- 2024 年度以降の設備投資計画は検討中。名古屋工場投資でピークを迎えるものの、東京近郊で設備投資を検討する可能性はある。さらに海外アプリケーションセンタの投資も勘案すると、今後、一定の投資を行う可能性は否定できない。

11. 現在の SPE 製品納期を伺いたい。

- プローバ：300 mm フレームで概ね 6-10 か月、200 mm フレームは引き続き 10 か月超となっている。
- ダイサ：概ね 3 か月程度。

12. 貿易規制による影響や、駆け込み需要の有無などがあれば伺いたい。

- 日本の輸出貿易管理令改正案によれば、当社の製品は対象外であると考えられるが、解釈が難易な文言があり、パブリックコメントを提出している。
- 一部の商社から、規制後を見据えた在庫確保と思われる商談を受けたが、最終需要家が明確でない案件であり、お断りしている。

13. SPE と計測のシナジーについて、2025 年に 130 億円超の効果と示されたが、この詳細を伺いたい。

- 半導体製造プロセスにおける当社計測の活用、ならびに、ビルトインの 2 つがある。具体的には、当社のプローバに計測機器を搭載し、測定点を 3 次元的に測定するもので、すでに対応機器を販売している。またビルトインでは、ダイサへの展開を開始している。今後はグラインダ、CMP などへ搭載できるよう プロジェクトを進めている。これらの売上増加、付加価値向上を試算し、数字を算出した。

14. プローバの高精度温度制御に関する事業機会について、詳細に伺いたい。

- 従前より、ウェーハを高温、低温環境で測定するニーズは存在し、現在の受注案件の半分程度は低温環境を求められる。しかし、高精度なデバイスでは、測定時の発熱量が増え、正確な検査が妨げられる。これに対応するためには、従前以上の高精度温度制御が必須となる。当社はこれに対応したプローバをすでに販売しているが、この需要がさらに増加すると想定する。特にメモリデバイスではこの機能が必須になり、大きな事業機会を創出すると見込んでいる。

以上